证券代码：002916　　证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-25

投资者关系活动类别	√特定对象调研　□分析师会议　□现场参观 □媒体采访　□业绩说明会　□新闻发布会 □路演活动　□其他　（　　）
活动参与人员（排名不分先后）	Goldman Sachs、Polymer Capital(HK)、Mirae Asset Global Investment (HK)、Valliance Asset Management
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2026 年 11 月 6 日
地点	公司会议室
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	**交流主要内容：** **Q1、请介绍公司 2026 年三季度经营业绩情况。** 2026 年三季度，公司实现营业收入 104.78 亿元，同比增长 66.29%；归母净利润 18.78 亿元，同比增长 94.42%；扣非归母净利润 18.58 亿元，同比增长 102.78%。上述变动得益于 AI 算力基础设施投资、产品迭代升级带来的市场机遇，带动 PCB、封装基板及 PCBA 业务相关需求增长。其中 AI 加速卡、服务器及相关配套产品需求持续提升，高速交换机、光模块收入明显增长，应用处理器类及存储类封装基板订单收入快速释放，产品结构持续优化；叠加广州、南通生产基地产能稳步爬坡，推动营业收入及利润实现同比增长。 **Q2、请介绍 2026 年三季度公司 PCB 业务各下游领域经营拓展情况。** PCB 产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。2026 年三季度，公司 PCB 业务收入环比明显增长，数据中心领域收入占比提升，有线通信业务收入持续增长，其余业务领域占比与二季度基本一

	致。 **Q3、请介绍 2026 年三季度封装基板业务经营拓展情况。** 公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片类封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2026 年三季度，PMIC 和应用处理器芯片类封装基板产品收入快速增长、占比提升。 **Q4、请介绍公司近期工厂产能利用率情况。** 受益于 AI 算力基础设施投资、产品迭代升级，带动 PCB、封装基板及 PCBA 业务相关需求增长，公司工厂综合产能利用率仍处于高位运行。 **Q5、请介绍广州封装基板项目爬坡进展。** 2026 年三季度，公司广州生产基地产能稳步释放，产品线能力持续提升。其中，BT 类封装基板产能爬坡稳步推进；FC-BGA 类封装基板已具备 26 层及以下产品批量生产能力，30 层及以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。 **Q6、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。** 公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2026 年三季度，受大宗商品价格变化影响，金盐等部分原材料价格同比提升、环比亦有一定涨幅。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。 **Q7、请介绍公司 2026 年三季度资本开支的方向。** 2026 年三季度，公司资本开支主要聚焦 PCB 与封装基板业务，重点投向无锡、南通、广州项目建设；同时适时开展技术改造，打开瓶颈、释放产能。 **Q8、请介绍当前公司 AI 算力领域产品需求情况。** 当前公司算力相关业务需求持续向好，AI 服务器、高速交换机、光模块及处理器类载板等产品订单饱满。公司已与多家算力、芯片领域核心客户建立稳定合作关系，为后续产能落

	地与业务增长筑牢基础。伴随算力类高附加值产品占比持续提升，广州、南通、无锡各基地产能稳步爬坡，公司产品结构持续优化，盈利能力逐季提升，长期发展前景清晰向好。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无